

1. 発行者情報

(1)名称(日本語)	中芯国際集成电路制造有限公司		
(英語)	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION		
(カタカナ)	セミコンダクター マニュファクチャリング インターナショナル		
(2)本店所在地	Suite 3003, 30th Floor, 9 Queen's Road Central, Hong Kong		
(3)①設立の準拠法	ケイマン諸島会社法	②法的地位	特例有限責任会社
③設立年	2000年		
(4)決算期	12月	(5)発行済株式数	5,039,819,199 株 (2018/12/31時点)
(6)事業内容	集積回路の設計・製造などを手がける。		
(7)経理の概要	詳細は 年次報告書(※) を参照のこと。		
		2018/12	2017/12
総資産額	(USD)	14,424,320,000	(USD) 11,918,451,000
負債額	(USD)	5,500,740,000	(USD) 5,197,116,000
株主資本額	(USD)	5,453,966,000	(USD) 5,168,960,000

*1. (2)本店所在地は香港証券取引所のウェブサイトにPrincipal Officeとして記載されている住所。

2. 証券情報

(1)株式の種類及び名称	普通株式
(2)①発行地	香港
②上場している外国の金融商品取引所	(出典：年次報告書) 香港証券取引所

(3)株価の推移 <チャート>を参照のこと。

2018/1/1~2018/12/31

年間最高値	(HKD)	13.700
年間最安値	(HKD)	5.880

* 「株価の推移」および「株価チャート」は、株式分割等の権利調整後の値。

(4)業績推移		2018/12		2017/12
売上高	(USD)	3,359,984,000	(USD)	3,101,175,000
当期純利益	(USD)	134,055,000	(USD)	179,679,000
株主資本額	(USD)	5,453,966,000	(USD)	5,168,960,000
(5)1株当たり情報		2018/12		2017/12
1株当たり純利益(基本)	(USD)	0.03	(USD)	0.04
1株当たり純利益(希薄後)	(USD)	0.03	(USD)	0.04
1株当たり配当額	(USD)	0	(USD)	0

*2. (5)1株当たり配当額：会計年度に係る配当額として提案された数値が年次報告書に記載されている場合には、その金額を記載。記載されていない場合には会計年度中に支払われた金額を記載。

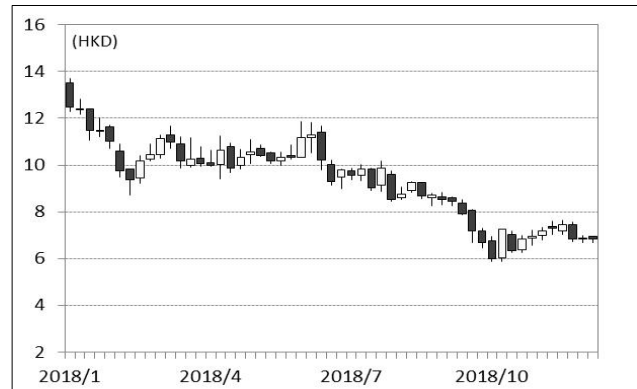
■備考

<通貨単位> HKD:香港ドル、USD:米ドル

<会計基準> 国際財務報告基準

(※) 年次報告書 <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0429/1tn20190429491.pdf>

<チャート>



<ご留意いただきたい事項>

- (注1) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該外国証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。
- (注2) 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
- (注3) 本資料は年次報告書、目論見書などに基づいて作成したものであるため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書、目論見書などで開示された後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。また本資料には、年次報告書、目論見書などに記載されている、主たる上場取引所以外の他の取引所への上場の状況が原則として記載されます。この場合、実際には他の取引所に上場されているものであっても、年次報告書、目論見書などに記載がされていなければ、注記されないことがあります。
- (注4) 株価(価格)の推移の記載のあるものは、特に注記のない限り、原則として本資料作成の対象となる会計年度の期間を対象としています。株式分割、株式併合、または資本の増減があった場合には、それ以前の株価を遡及修正しています。